

瑞鼎科技

Raydium Semiconductor Corp.

2026年第一季法人說明會

免責聲明

- 本簡報所提及之內容，係本公司基於公司資料及現況所得之資訊，未來如有進一步發展或調整本公司將另依法公開訊息，但不更新或修正本簡報。
- 本報告中的內容，並非投資建議。

Agenda

- 1 公司簡介
- 2 2026年第一季營運成果
- 3 近期重要事件與營運重點訊息
- 4 問與答

1 公司簡介

2 2026年第一季度營運成果

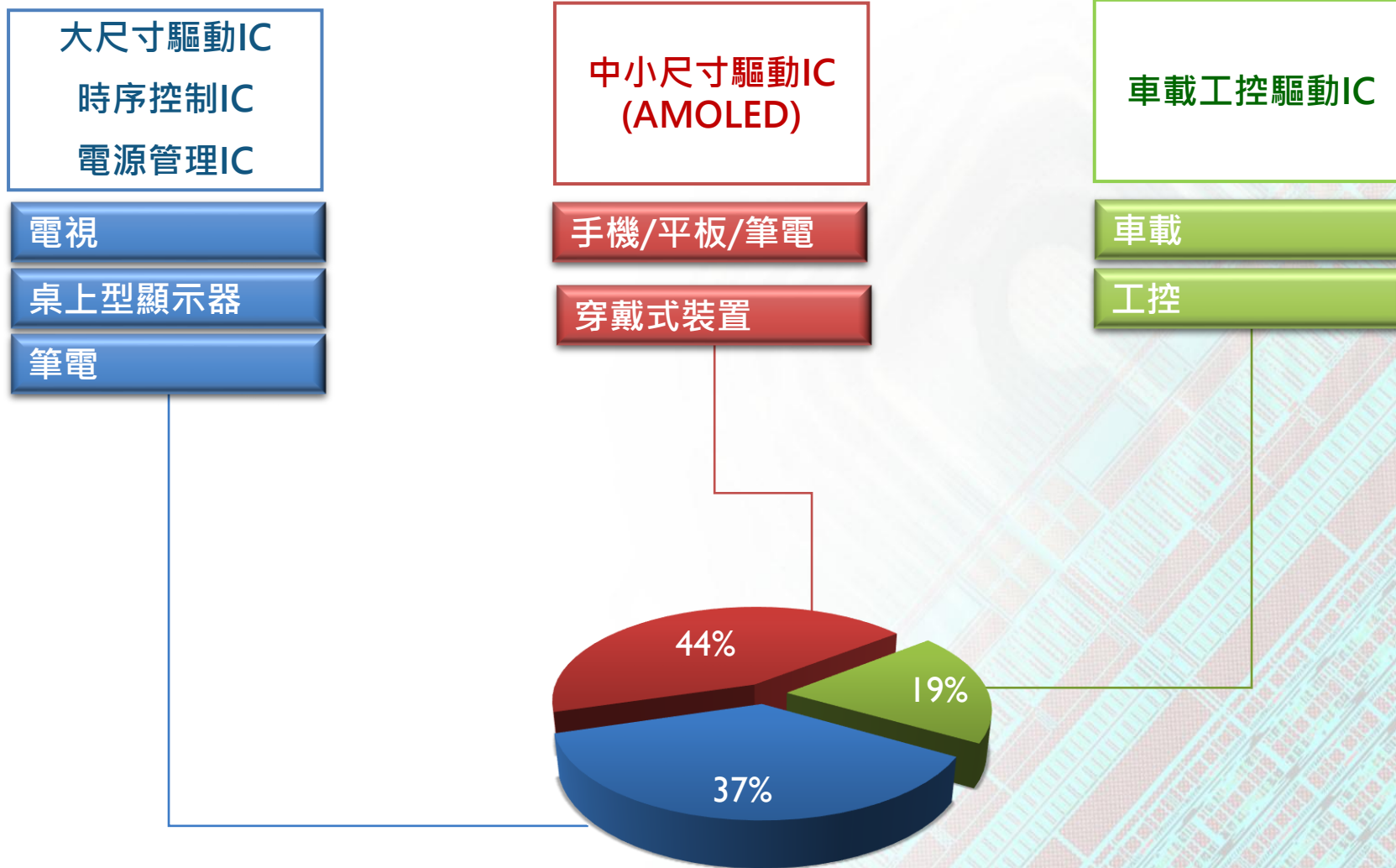
3 近期重要事件與營運重點訊息

4 問與答

公司簡介

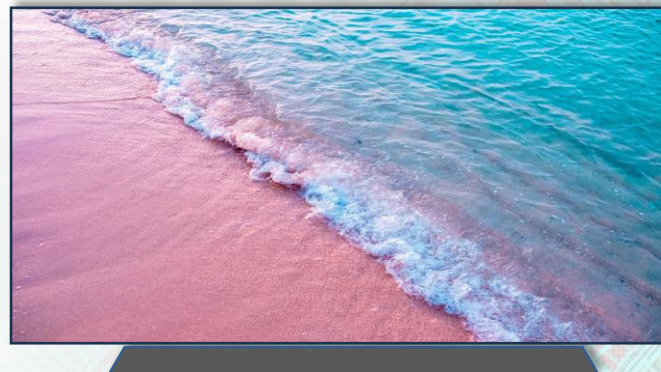


產品組合



1Q26 營業額 : NTD 54.4億元

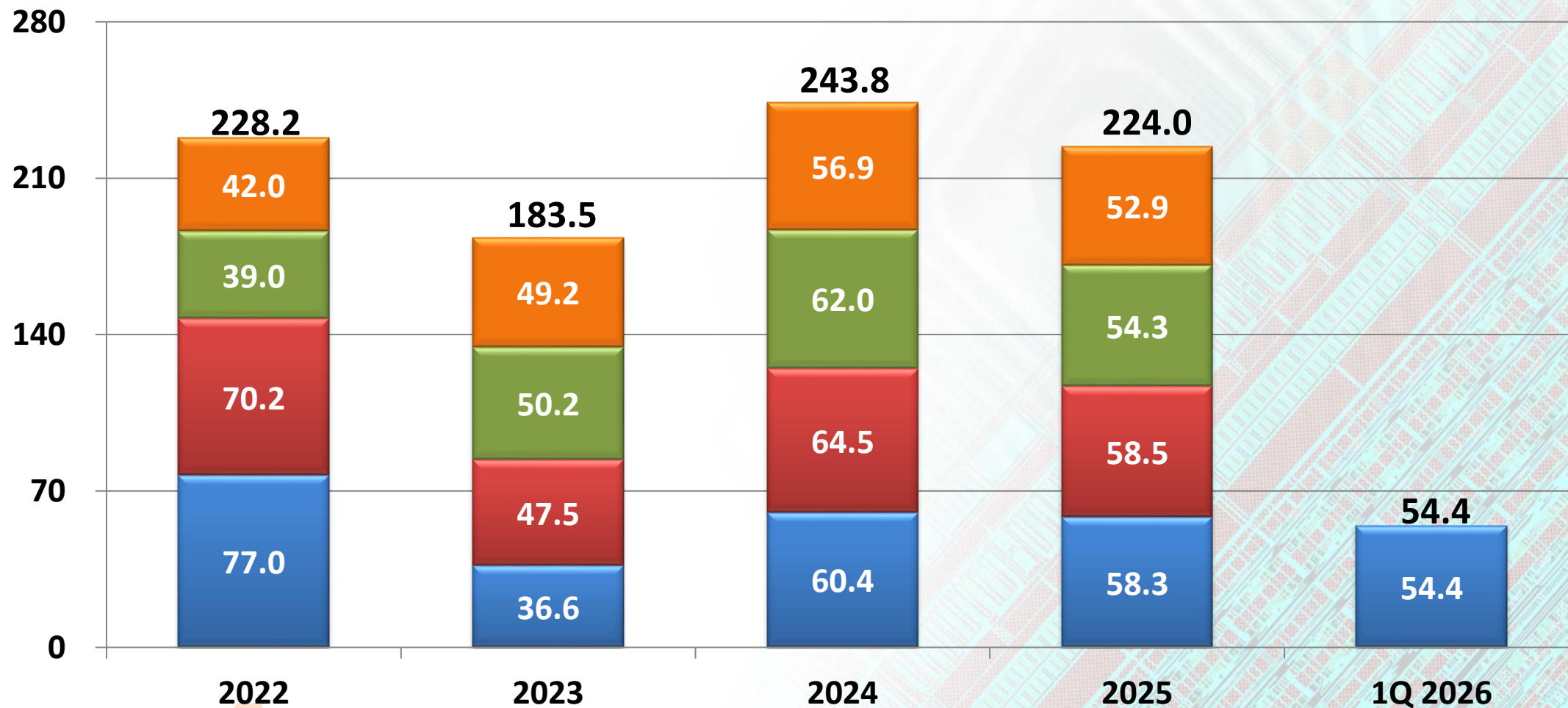
產品應用



2022~1Q 2026 合併營業額

單位：NTD億元

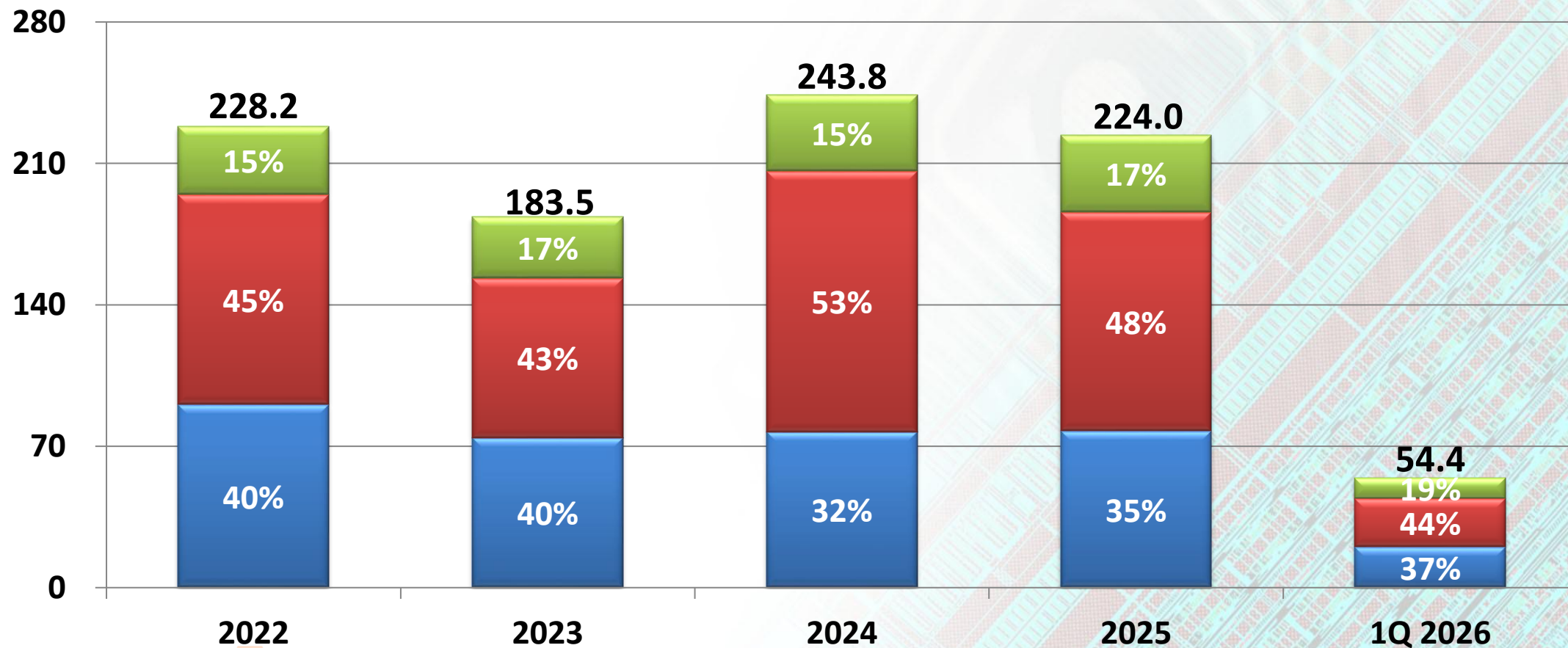
■ Q1 ■ Q2 ■ Q3 ■ Q4



2022~1Q 2026 合併營業額

■ 大尺寸驅動/時序控制/電源管理IC ■ 中小尺寸驅動IC ■ 車載/工控驅動IC

單位：NTD億元



1

公司簡介

2

2026年第一季營運成果

3

近期重要事件與營運重點訊息

4

問與答

合併綜合損益表 (1Q26 QoQ & YoY)

Unit: NTD Million

	1Q26	4Q25	QoQ	1Q25	YoY
Revenue/ 營業收入	5,437	5,294	2.7%	5,826	(6.7%)
Gross Profit/ 營業毛利	1,554	1,537	1.1%	1,721	(9.7%)
Operating Expenses/ 營業費用	1,267	1,263	0.3%	1,257	0.8%
Operating Income/ 營業淨利	287	274	4.9%	464	(38.2%)
Non-operating Income and Expenses/ 營業外收支	50	85	(41.4%)	74	(32.3%)
Income Before Income Tax/ 稅前淨利	337	359	(6.1%)	538	(37.4%)
Net Income/ 本期淨利	290	315	(8.0%)	459	(36.9%)
Gross Profit %/ 營業毛利率	28.6%	29.0%	(0.4%)	29.5%	(0.9%)
Operating Income %/ 營業淨利率	5.3%	5.2%	0.1%	8.0%	(2.7%)
Net Income %/ 本期淨利率	5.3%	5.9%	(0.6%)	7.9%	(2.6%)
Basic EPS/ 基本每股盈餘(元)	3.82	4.15	(0.33)	6.05	(2.23)

合併資產負債表-2026/3/31

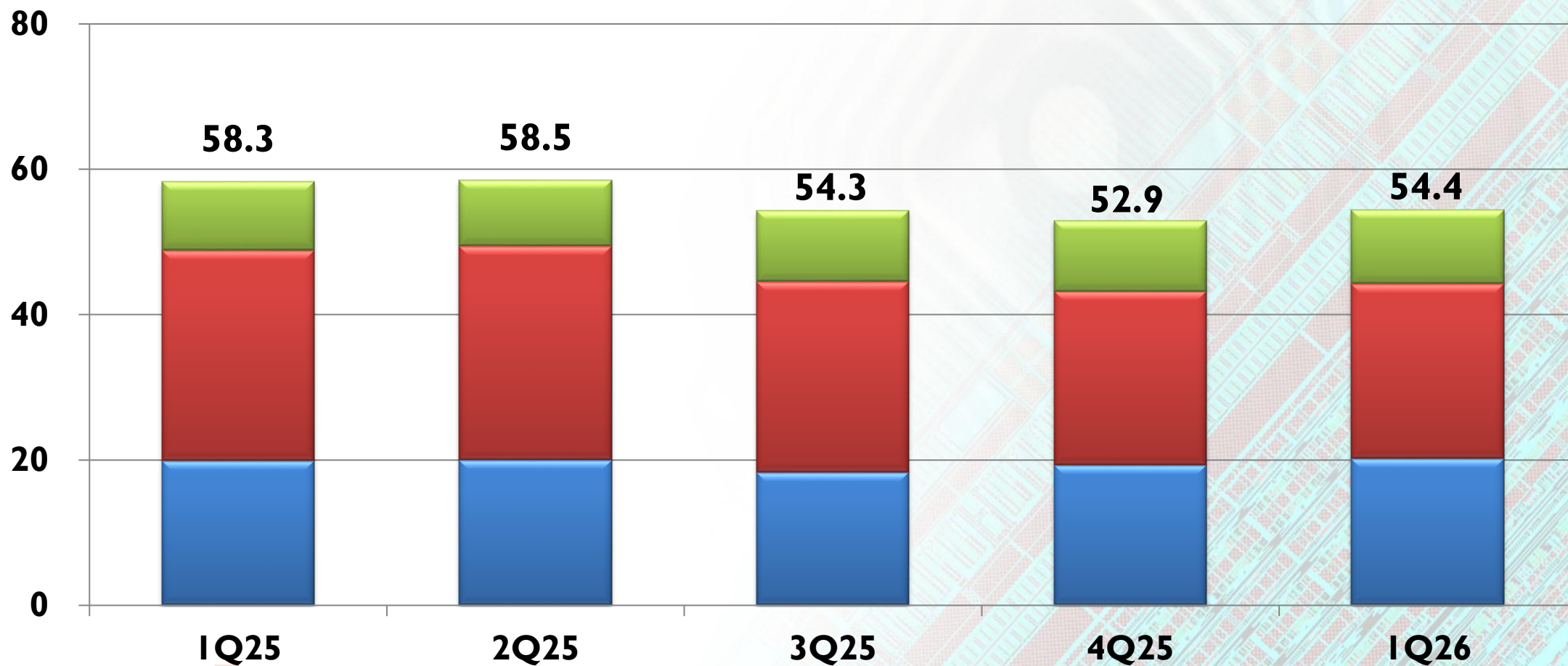
Unit: NTD Million

	2026/3/31	2025/12/31	QoQ	2025/3/31	YoY
Cash and cash equivalents/ 現金及約當現金	3,957	3,771	4.9%	6,140	(35.6%)
Accounts receivable/ 應收帳款	3,968	3,817	4.0%	3,727	6.5%
Inventories/ 存貨	2,580	2,284	13.0%	2,553	1.1%
Other current assets/ 其他流動資產	6,552	7,463	(12.2%)	6,494	0.9%
Non-current assets/ 非流動資產	2,448	2,324	5.3%	1,941	26.1%
Total assets/ 資產總計	19,505	19,659	(0.8%)	20,855	(6.5%)
Current liabilities/ 流動負債	8,493	7,694	10.4%	9,528	(10.9%)
Non-current liabilities/ 非流動負債	257	445	(42.2%)	573	(55.1%)
Total equity/ 股東權益	10,755	11,520	(6.6%)	10,754	0.0%
Total liabilities and equity/ 負債與權益	19,505	19,659	(0.8%)	20,855	(6.5%)

1Q25~1Q26 合併季營收

■ 大尺寸驅動/時序控制/電源管理IC ■ 中小尺寸驅動IC ■ 車載/工控驅動IC

單位：NTD億元



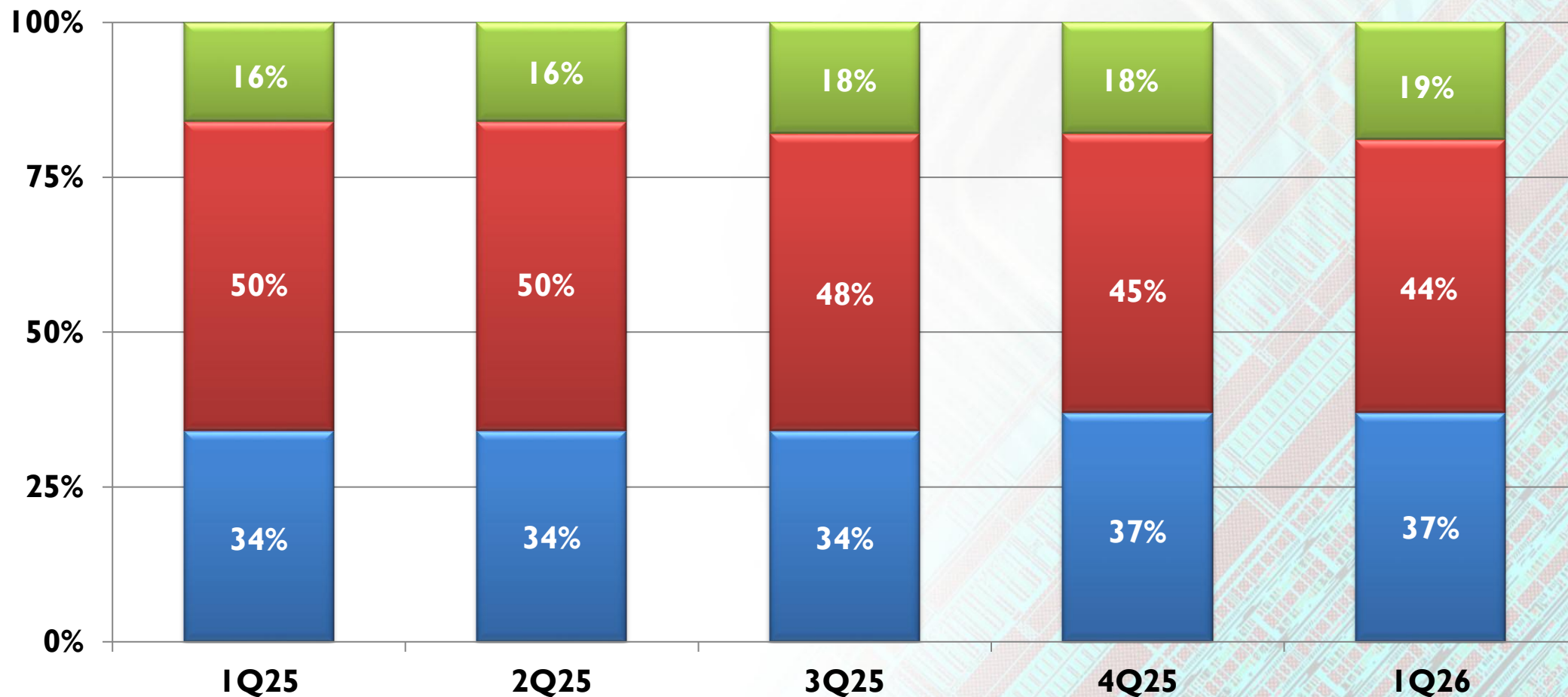
IQ25~IQ26 產品組合

■ 大尺寸驅動/時序控制/電源管理IC

■ 中小尺寸驅動IC

■ 車載/工控驅動IC

單位：%



1

公司簡介

2

2026年第一季營運成果

3

近期重要事件與營運重點訊息

4

問與答

近期重要事件摘要



TWSE公司治理評鑑 | 連續三年前20%

本公司於於臺灣證券交易所主辦之
公司治理評鑑中，連續三年名列
上市公司第二級距(前6%~20%)

- ✓ 2023年(首年參加)
- ✓ 2024年
- ✓ 2025年

近期營運重點訊息 - 1/2

● 1Q26 營運重點回顧

✓ 整體營收在傳統淡季中仍較前一季呈現溫和成長：

✓ 三大產品線：

- 大尺寸驅動IC：

- TV與IT應用(桌上型顯示器與筆記型電腦)皆因部分客戶提前備貨帶動需求成長，其中電視與筆記型電腦出貨動能較強

- 中小尺寸AMOLED驅動IC：

- 智慧型手機受記憶體價格上漲影響，品牌客戶備貨策略轉趨審慎以致需求略顯保守，惟高階穿戴裝置在客戶滲透率持續提升及應用場景擴展帶動下需求動能維持穩定，支撐中小尺寸AMOLED驅動IC整體營收表現大致持平

- 車載工控驅動IC：

- 需求保持穩健成長動能

近期營運重點訊息 - 2/2

● 2Q26 營運重點

✓ 三大產品線需求：

- 大尺寸驅動IC：整體營運動能預期季增
 - 因受AI強勁需求排擠上游晶圓代工及封測產能的分配，加上成本的上升壓力，品牌廠持續要求供應鏈提前備貨，需求動能增溫
- 中小尺寸AMOLED驅動IC：整體需求回溫
 - 智慧型手機 DDIC：受惠於客戶新機上市備貨以及上游供應鏈漲價影響，要求提前備貨，預期出貨增溫
 - 穿戴式產品DDIC：可望維持穩定表現
- 車載工控驅動IC：
 - 整體需求預期維持穩健成長態勢

1

公司簡介

2

2026年第一季營運成果

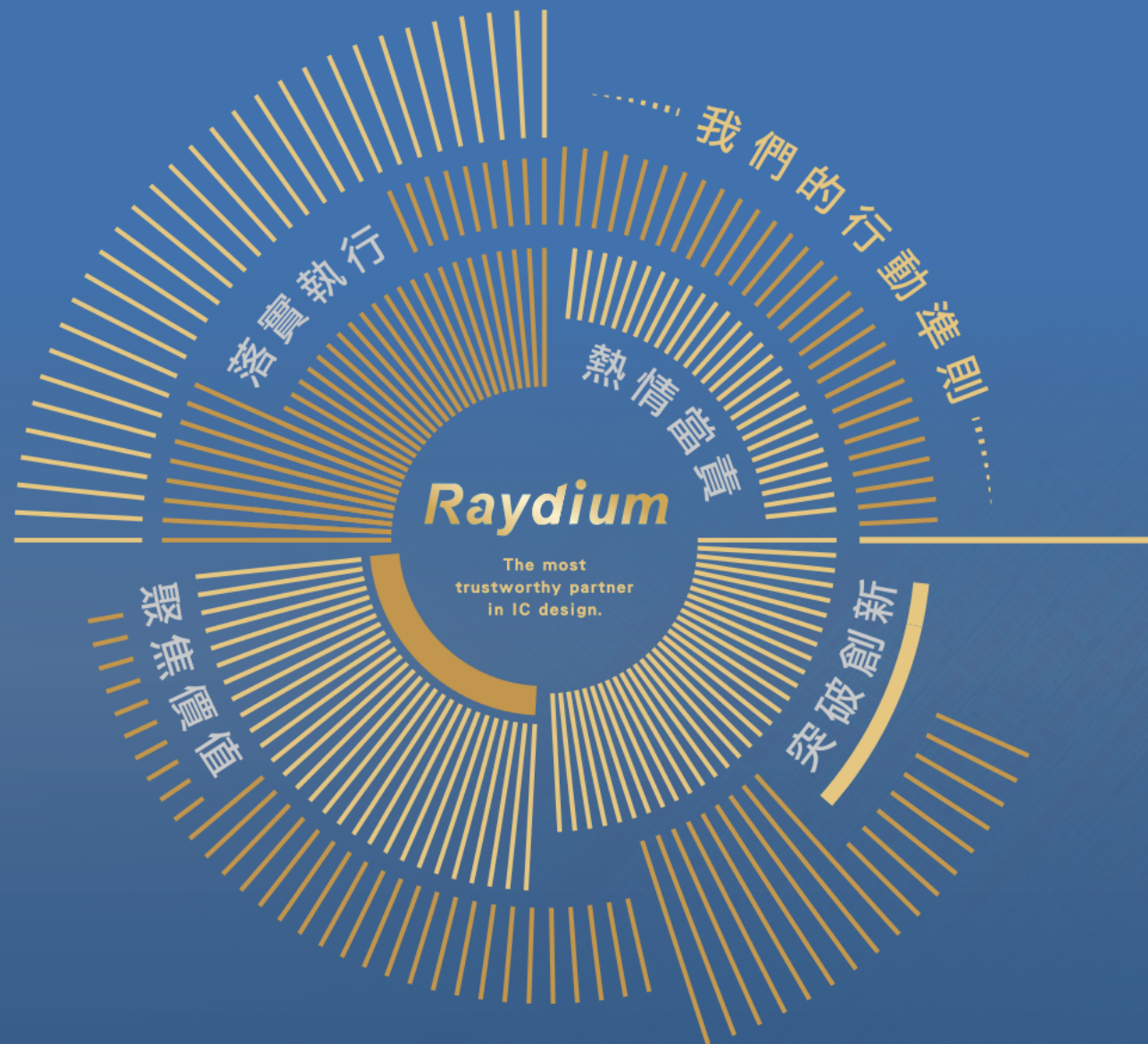
3

近期重要事件與營運重點訊息

4

問與答

Q&A



Raydium



We Differentiate By Technology

